

东吴证券股份有限公司

关于

苏州冠礼科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之

发行保荐书

保荐人（主承销商）



（注册地址：苏州工业园区星阳街5号）

东吴证券股份有限公司

关于苏州冠礼科技股份有限公司

首次公开发行股票并在创业板上市

之发行保荐书

深圳证券交易所：

苏州冠礼科技股份有限公司（以下简称“发行人”、“冠礼科技”或“公司”）拟申请首次公开发行股票并在创业板上市，并委托东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐人”或“东吴证券”）作为首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人。

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《首次公开发行股票注册管理办法》（以下简称“《注册办法》”）和《证券发行上市保荐业务管理办法》（以下简称“《保荐业务管理办法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）、深圳证券交易所（以下简称“深交所”）的相关规定，本保荐人及保荐代表人诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本发行保荐书，并保证本发行保荐书的真实性、准确性和完整性。

如无特别说明，本发行保荐书中的简称或名词的释义与发行人为本次发行制作的招股说明书相同。

目 录

目 录.....	2
第一节 本次证券发行基本情况	3
一、本项目保荐代表人及其保荐业务执业情况.....	3
二、本项目项目协办人及项目组其他成员情况.....	3
三、发行人基本情况.....	4
四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明.....	6
五、本保荐人内部审核程序和内核意见.....	7
第二节 保荐人承诺事项	10
第三节 对本次证券发行的推荐意见	11
一、本保荐人对本次证券发行的推荐结论.....	11
二、本次证券发行发行人履行的决策程序.....	11
三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件.....	11
四、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件.....	12
五、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关 事项的指导意见》有关事项的核查意见.....	15
六、关于发行人及其持股 5%以上的主要股东等责任主体做出的承诺及约束 措施事项的核查意见.....	16
七、关于发行人私募投资基金股东登记备案情况的核查意见.....	16
八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查.....	17
九、发行人存在的主要风险.....	17
十、发行人发展前景的评价.....	22

第一节 本次证券发行基本情况

一、本项目保荐代表人及其保荐业务执业情况

东吴证券作为冠礼科技首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，指派具体负责推荐的保荐代表人为张博雄和夏建阳。

张博雄先生：东吴证券投资银行业务管理委员会业务总监，保荐代表人、注册会计师、硕士研究生，11年投资银行从业经历。曾担任圣晖集成（603163）IPO项目保荐代表人，组织或参与赛英电子（920181）、龙腾光电（688055）、中泰证券（600918）、南京证券（601990）、高科石化（002778）的首次公开发行，迈为股份（300751）的非公开发行，高科石化（002778）重大资产重组等项目。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

夏建阳先生：东吴证券投资银行业务管理委员会业务总监，保荐代表人、注册会计师、硕士研究生，18年投资银行从业经历。曾组织或参与上海凯宝（300039）IPO、蓝丰生化（002513）IPO、南京银行（601009）2015年非公开发行优先股、高科石化（002778）IPO、南京证券（601990）IPO、中泰证券（600918）IPO、上声电子（688533）IPO、圣晖集成（603163）IPO、中裕科技（871694）北交所IPO、赛英电子（920181）北交所IPO等项目，以及多家企业的财务顾问工作。在保荐业务执业过程中严格遵守《证券发行上市保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。

二、本项目项目协办人及项目组其他成员情况

（一）项目协办人

东吴证券指派姜振兴作为本次发行的项目协办人。

姜振兴先生：注册会计师，曾参与固德电材（301680）、福立旺（688678）首次公开发行及多家企业的财务顾问等工作。

（二）项目组其他成员

本次证券发行项目组其他成员为：吴含舒、薛佳梓、崔琪、陆逸峰、骆云天、赵桢宇。

三、发行人基本情况

（一）基本情况

中文名称	苏州冠礼科技股份有限公司
注册资本	21,000.00 万元
法定代表人	梁进利
有限责任公司成立日期	2016 年 5 月 31 日
整体变更为股份公司日期	2025 年 10 月 22 日
住所	苏州高新区浒墅关开发区石林路 189 号
邮政编码	215151
联系电话	0512-88169099
联系传真	0512-88169099
互联网网址	www.winmaxtech.com
电子信箱	invest@winmaxtech.com
本次证券发行类型	人民币普通股股票（A 股）
每股面值	人民币 1.00 元
发行数量	本次公开发行股份数量不超过 7,000.00 万股

（二）主营业务

公司专注高纯工艺介质系统及高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售，服务于集成电路、显示面板及电子化学品等泛半导体产业，围绕产业链液态化学品全流程管理需求，提供从系统设计、生产制造、现场安装调试、验收交付到后期运维管理的一站式整体解决方案。公司高纯工艺介质系统支持各类液态化学品的纯化、分装、混配、储存、输送及回收再生，通过调节关键工艺参数对微污染物进行精密控制，保障液态化学品在生产过程中的洁净度、稳定性与安全性，实现持续可靠的供应；公司高阶湿制程工艺设备可应用于泛半导体制造中清洗、

显影、刻蚀及去胶等关键工艺环节，是晶圆制造过程中不可或缺的重要装备，其洁净度控制能力与工艺稳定性直接影响产品良率与制程一致性。

作为国内高纯工艺介质系统领域的先行者，公司潜心耕耘二十余载，依托长期积累的工艺理解与系统交付经验，构建起覆盖自动化化学品与研磨液供应系统、电子级化学品纯化及分装系统、废化学品再生系统以及高阶湿制程工艺设备的产品体系，形成支撑先进制造并推动资源循环利用的业务布局。公司主要产品在各领域的应用示意图如下：



公司始终秉承自主创新、技术深耕的研发理念，历经持续攻关与实践，取得了丰硕的积累。公司是国家级专精特新重点“小巨人”企业、国家级专精特新“小巨人”企业、国家高新技术企业、江苏省企业技术中心、江苏省高新区瞪羚企业，并荣获国家优质工程金奖、江苏省高阶湿制程清洗设备工程技术研究中心、“三首两新”认定技术产品企业等多项国家级及省级认证荣誉，亦是国家标准《电子工厂化学品系统工程技术规范》（GB 50781-2012）的主要参编单位。截至

报告期末，公司已获得发明专利 64 项，实用新型专利 112 项、外观设计专利 18 项，并拥有计算机软件著作权 51 项，为业务拓展奠定坚实的技术基础。

公司以多学科交叉创新为驱动，以自主知识产权体系为依托，形成具备迭代能力的核心竞争优势。凭借扎实的技术积累、可靠的产品性能及完善的服务体系，公司赢得了众多优质客户的认可与信赖，已与中芯国际、华虹半导体、合肥晶合、长江存储、长鑫存储等国内行业头部企业建立起稳固的合作关系；报告期内，亦收获了深圳市新凯来技术有限公司等行业新兴企业的青睐。同时，公司积极推动全球化布局，通过新加坡、马来西亚海外子公司搭建国际运营服务网络，成功开拓增长新空间，与住友化学等国际知名客户达成合作。未来，公司将继续聚焦技术创新与产品升级，以高品质产品供给与专业化服务保障为支撑精准匹配客户需求，把握产业发展机遇，稳步拓展市场，巩固业务基础并提升核心竞争力。

四、保荐人是否存在可能影响公正履行保荐职责情形的说明

（一）本保荐人及控股股东、实际控制人、重要关联方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份（本次发行战略配售除外）；

（二）发行人及其控股股东、重要关联方除可能存在少量、正常的二级市场证券投资外，不存在持有保荐人或其控股股东、实际控制人、重要关联方股份的情况；

（三）保荐人的保荐代表人及其配偶，董事、监事、高级管理人员不存在持有发行人或其控股股东及重要关联方股份，不存在在发行人或其控股股东及重要关联方任职的情况；

（四）保荐人的控股股东、实际控制人、重要关联方与发行人控股股东、重要关联方不存在相互提供担保或者融资的情况；

（五）保荐人与发行人之间不存在其他关联关系。

五、本保荐人内部审核程序和内核意见

（一）东吴证券实施的内部审核程序

本保荐人在向中国证监会、深圳证券交易所推荐本项目前，通过项目立项审批、投资银行业务管理委员会质控中心质量控制部审核、投资银行业务问核委员会问核及投资银行业务内核委员会审核等内部核查程序对项目进行质量管理和风险控制，履行了审慎核查职责。主要工作程序包括：

1、立项审核

项目小组在初步尽职调查后出具立项申请报告，经所在业务部门负责人同意后，报投资银行质量控制部门审核；质量控制部门审核通过后，将项目的立项申请报告、初审结果等相关资料提交投资银行业务立项审议委员会审核；投资银行业务立项审议委员会审核通过后，向投资银行项目管理部门备案。投资银行的相关业务须经过立项审核程序后方可进入到项目执行阶段。

2、质量控制部审查

项目执行阶段，投资银行业务管理委员会质控中心质量控制部（以下简称“质量控制部”）在辅导期和材料申报两个阶段，对项目组的尽职调查工作进行了不少于2次的检查，分别为辅导中期预检查及内核前现场检查。现场检查由质量控制部组织实施，对于内核前现场检查，质量控制部的质控小组组长指定至少1名组员参与现场检查工作。

辅导阶段，质量控制部对项目组辅导期以来的文件从发行人的治理结构、资产状况、财务状况、发展前景以及项目组辅导工作情况等方面进行了审查。

制作申报材料阶段，质量控制部对项目组尽职调查工作质量、工作底稿是否真实、准确、完整地反映了尽职推荐发行人证券发行上市所开展的主要工作、是否能够成为发行人出具相关申报文件的基础等角度进行了审查，并对存在的问题提出改进意见。项目组根据质量控制部的初步审核意见进一步完善申请文件的有关内容。整改完毕后，质量控制部结合现场检查情况形成质量控制报告。

3、项目问核

投资银行业务问核委员会以问核会议的形式对项目进行问核。问核人员对《保荐项目重要事项尽职调查情况问核表》中所列重要事项逐项进行询问，保荐代表人逐项说明对相关事项的核查过程、核查手段及核查结论。

问核人员根据问核情况及工作底稿检查情况，指出项目组在重要事项尽职调查过程中存在的问题和不足，并要求项目组进行进一步整改。项目组根据问核委员会的要求对相关事项进行补充尽职调查，并补充、完善相应的工作底稿。

4、内核机构审核

项目组履行问核程序后，向投资银行业务内核常设机构提出内核申请。投资银行内核常设机构经预审后认为项目符合提交公司投资银行业务内核委员会审议的条件后，安排召开内核会议。与会内核委员就项目是否符合法律法规、规范性文件和自律规则的相关要求，尽职调查是否勤勉尽责进行了审核，并形成内核会议反馈意见。

项目组落实内核会议反馈意见并书面回复后，投资银行内核常设机构对项目组提交的内核会议反馈意见回复及相应修改完善的相关材料进行预审，预审通过后，投资银行内核常设机构将前述材料提交与会内核委员进行审核并投票表决。

内核常设机构负责统计内核会议表决结果，并制作内核会议决议和会议记录文件由参会内核委员确认。内核会议表决结果为通过的，项目方能办理相关申报手续。

保荐人投资银行业务内核委员会就发行人首次公开发行股票并在创业板上市项目进行了审议，形成如下意见：

发行人首次公开发行股票并在创业板上市符合法律法规及相关规定，同意东吴证券保荐承销该项目。

（二）东吴证券内核意见

东吴证券投资银行业务内核委员会对发行人首次公开发行股票并在创业板

上市申请文件进行了逐项审核。投资银行业务内核委员会认为：

发行人首次公开发行股票并在创业板上市符合法律法规及相关规定，同意东吴证券保荐承销该项目。

第二节 保荐人承诺事项

一、本保荐人承诺：已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

二、本保荐人已按照中国证监会的有关规定对发行人进行了辅导、进行了充分的尽职调查，并承诺：

（一）有充分理由确信发行人符合法律法规及中国证监会有关证券发行上市的相关规定；

（二）有充分理由确信发行人申请文件和信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（三）有充分理由确信发行人及其董事在申请文件和信息披露资料中表达意见的依据充分合理；

（四）有充分理由确信申请文件和信息披露资料与证券服务机构发表的意见不存在实质性差异；

（五）保证所指定的保荐代表人及相关人员已勤勉尽责，对发行人申请文件和信息披露资料进行了尽职调查、审慎核查；

（六）保证发行保荐书、与履行保荐职责有关的其他文件不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；

（七）保证对发行人提供的专业服务和出具的专业意见符合法律、行政法规、中国证监会的规定和行业规范；

（八）自愿接受中国证监会依照《保荐业务管理办法》采取的监管措施。

第三节 对本次证券发行的推荐意见

一、本保荐人对本次证券发行的推荐结论

本保荐人按照《公司法》《证券法》《注册办法》《保荐业务管理办法》等法律法规和中国证监会的有关规定，通过尽职调查和对申请文件的审慎核查，认为发行人具备首次公开发行股票并在创业板上市的基本条件。发行人法人治理结构健全，内部管理、运作规范；财务状况良好，有较好的持续盈利能力；募集资金投向符合国家产业政策和公司发展战略；申请文件的制作符合中国证监会的相关规定和标准。发行人符合首次公开发行股票并在创业板上市的条件，本保荐人同意推荐发行人首次公开发行股票并在创业板上市。

二、本次证券发行发行人履行的决策程序

2026年3月12日，发行人召开2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司申请首次公开发行股票并在创业板上市的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》《关于公司首次公开发行股票募集资金投资项目及可行性分析的议案》《关于公司在首次公开发行股票前滚存利润由新老股东共享的议案》《关于股东会授权董事会办理首次公开发行股票并在创业板上市相关事宜的议案》等与本次证券发行上市相关的议案。

本保荐人认为，发行人已依据《公司法》《证券法》等有关法律法规及发行人公司章程的规定，就本次证券的发行履行了完备的内部决策程序。

三、本次证券发行符合《证券法》规定的发行条件

本保荐人对本次证券发行是否符合《证券法》第十二条规定的发行条件进行了尽职调查和审慎核查，核查结论如下：

（一）发行人具备健全且运行良好的组织机构

发行人《公司章程》合法有效，股东会、董事会、审计委员会和独立董事制度健全，能够依法有效履行职责；发行人具有生产经营所需的职能部门且运行良

好。符合《证券法》第十二条第一款第一项的规定。

（二）发行人具有持续经营能力

发行人系依法设立并有效存续的股份有限公司，截至本发行保荐书签署日，发行人的生产经营符合国家产业政策，发行人不存在因违法经营而被相关行政管理部门责令停业整顿或吊销营业执照的情形，不存在根据法律、法规及公司章程规定需要终止的情形。根据会计师出具的发行人报告期的审计报告等财务资料，发行人主营业务报告期的经营情况等业务资料，发行人具有持续经营能力，符合《证券法》第十二条第一款第二项的规定。

（三）发行人最近三年财务会计报告被出具无保留意见审计报告

会计师针对发行人最近三年的财务报告出具了标准无保留审计意见的《审计报告》，符合《证券法》第十二条第一款第三项的规定。

（四）发行人及其控股股东、实际控制人最近三年不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪

根据保荐人的审慎核查以及相关政府部门出具的证明，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，符合《证券法》第十二条第一款第四项的规定。

（五）符合经国务院批准的国务院证券监督管理机构规定的其他条件。

本保荐人认为，发行人符合《证券法》规定的关于首次公开发行新股的发行条件。

四、本次证券发行符合《注册办法》规定的发行条件

依据《注册办法》相关规定，本保荐人进行了尽职调查和审慎核查，认为发行人符合公开发行新股条件：

（一）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十条的规定

保荐人查验了发行人工商档案，发行人改制设立有关内部决策、审计、评估及验资文件，并核查了发行人现行有效的公司章程及报告期内的财务报表及审计报告。发行人前身冠礼有限成立于 2016 年 5 月，于 2025 年 10 月以股改基准日经审计的账面净资产值折股整体变更为股份有限公司，持续经营时间可以从有限责任公司成立之日起计算。保荐人认为，发行人是依法设立且持续经营三年以上的股份有限公司。

发行人已经依法建立健全股东会、董事会、审计委员会以及独立董事、董事会秘书、董事会专门委员会等制度，相关机构和人员能够依法履行职责。保荐人认为，发行人已经具备健全且运行良好的组织机构，相关机构和人员能够依法履行职责。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十条的规定。

（二）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十一条的规定

经核查发行人的会计记录、记账凭证等资料，结合会计师出具的《审计报告》，保荐人认为，发行人会计基础工作规范，财务报表的编制符合企业会计准则和相关会计制度的规定，在所有重大方面公允地反映了发行人的财务状况、经营成果和现金流量，并由注册会计师出具了标准无保留意见的审计报告。

经核查发行人的内部控制制度、内部控制执行记录，结合会计师出具的《内部控制审计报告》，保荐人认为，发行人内部控制制度健全且被有效执行，能够合理保证公司运行效率、合法合规和财务报告的可靠性，并由注册会计师出具了标准无保留结论的内部控制审计报告。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十一条的规定。

（三）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十二条的规定

经核查发行人业务经营情况、主要资产、专利、商标等资料，并结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，以及对发行人董事和高级管理

人员的访谈等资料，保荐人认为，发行人资产完整，业务及人员、财务、机构独立，与控股股东及其控制的其他企业间不存在对发行人构成重大不利影响的同业竞争，不存在严重影响独立性或者显失公平的关联交易，本次发行符合《注册办法》第十二条第（一）项的规定。

经核查发行人报告期内的主营业务收入构成、重大销售合同及主要客户、发行人工商档案及股东名册、聘任董事、高级管理人员的股东会决议和董事会决议、核心技术人员的劳动合同以及访谈文件、发行人控股股东出具的声明和承诺，结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人主营业务、控制权、管理团队和核心技术人员稳定，最近两年内主营业务和董事、高级管理人员均没有发生重大不利变化，公司的股份权属清晰，发行人无实际控制人，不存在导致控制权可能变更的重大权属纠纷，本次发行符合《注册办法》第十二条第（二）项的规定。

经核查发行人财产清单、主要资产的权属证明文件、企业信用报告、发行人涉及的诉讼仲裁、行业研究、分析报告等资料，结合与发行人管理层的访谈、会计师出具的《审计报告》和发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人不存在主要资产、核心技术、商标等的重大权属纠纷，重大偿债风险，重大担保、诉讼、仲裁等或有事项，经营环境已经或者将要发生重大变化等对持续经营有重大不利影响的事项，本次发行符合《注册办法》第十二条第（三）项的规定。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十二条的规定。

（四）发行人申请首次公开发行股票符合《注册办法》第十三条的规定

经核查发行人实际经营情况及开展相关业务所涉及的准入许可及相关资质情况，查阅了与发行人所从事行业相关的国家产业政策，发行人及其控股股东、董事、高级管理人员出具的调查表，董事、高级管理人员提供的无犯罪证明、个人征信报告，取得发行人住所地相关主管政府单位出具的证明文件，查询中国证监会、证券交易所等监管机构网站及其他公开信息，并结合发行人律师出具的《律师工作报告》和《法律意见书》，保荐人认为，发行人生产经营符合法律、行政

法规的规定，符合国家产业政策；最近三年内，发行人及其控股股东不存在贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社会主义市场经济秩序的刑事犯罪，不存在欺诈发行、重大信息披露违法或者其他涉及国家安全、公共安全、生态安全、生产安全、公众健康安全等领域的重大违法行为；发行人董事、高级管理人员不存在最近三年内受到中国证监会行政处罚，或者因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见等情形。

综上，保荐人认为，本次发行符合《注册办法》第十三条的规定。

五、关于发行人落实《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》有关事项的核查意见

根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的要求，发行人已召开第一届董事会第三次会议以及 2026 年第一次临时股东会，审议通过了《关于公司首次公开发行股票摊薄即期回报采取填补措施及承诺的议案》。

发行人直接控股股东及间接控股股东已出具承诺：“1、不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益。2、本承诺函出具后至公司本次发行上市实施完毕前，若中国证监会出台关于填补回报措施及其承诺的新规定，且本企业上述承诺不能满足中国证监会该等规定时，本企业承诺届时将按照中国证监会的最新规定出具补充承诺。3、本企业承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本企业违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本企业将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；给公司或者股东造成损失的，本企业愿意依法承担相应补偿责任。”

发行人全体董事、高级管理人员已出具承诺：“1、忠实、勤勉地履行职责，维护公司和全体股东的合法利益。2、本人不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他方式损害公司利益。3、对本人的职务消费行为进行约束。4、不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动。5、将促使公司董事会或薪酬与考核委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执

行情况相挂钩。6、若公司后续制定股权激励政策，本人将尽职促使拟公布的公司股权激励的行权条件与公司填补回报措施的执行情况相挂钩。7、本承诺函出具后至公司本次发行上市实施完毕前，若中国证监会出台关于填补回报措施及其承诺的新规定，届时按照新规定执行。8、本人承诺严格履行所作出的上述承诺事项，确保公司填补回报措施能够得到切实履行。如果本人违反所作出的承诺或拒不履行承诺，本人将按照相关规定履行解释、道歉等相应义务，自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管机构依法作出的监管措施；给公司或者股东造成损失的，本人愿意依法承担相应补偿责任。”

经核查，保荐人认为，发行人所预计的即期回报摊薄情况合理，填补即期回报措施及相关承诺主体的承诺事项符合《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》的相关规定，亦符合《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作意见》中关于保护中小投资者合法权益的精神。

六、关于发行人及其持股 5% 以上的主要股东等责任主体做出的承诺及约束措施事项的核查意见

根据中国证监会于 2013 年 11 月 30 日发布的《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》（证监会公告[2013]42 号）等相关文件的要求，发行人、控股股东、持股 5% 以上的主要股东、全体董事、高级管理人员做出的公开承诺内容合法、合理，失信补救措施及时有效，符合中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等法规的规定。

七、关于发行人私募投资基金股东登记备案情况的核查意见

根据《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》等相关法律法规和自律规则的规定，本保荐人获取了发行人的股东名册、工商档案以及部分股东出具的说明等相关资料，并通过查询国家企业信用信息公示系统、企查查等网络工具对发行人股东中的私募投资基金情况进行核查。

经核查，保荐人认为，发行人直接股东中不存在私募投资基金股东，不需要

履行备案程序。

八、关于有偿聘请第三方机构和个人等相关行为的核查

根据《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）等规定，本保荐人就本次发行上市中在依法需聘请的证券服务机构之外是否聘请第三方及相关聘请行为的合法合规性进行了核查。

（一）本保荐人有偿聘请第三方等相关行为的核查

本保荐人未有偿聘请第三方。

（二）发行人有偿聘请第三方等相关行为的核查

保荐人对冠礼科技有偿聘请第三方机构和个人情况进行了核查。经核查，冠礼科技本次发行上市中聘请本保荐人担任保荐人，聘请上海市锦天城律师事务所担任发行人律师，聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）担任审计、验资机构及验资复核机构，聘请中盛评估咨询有限公司担任资产评估机构，聘任惠施法律事务所、Shaun Wong LLC、Christopher Yeo & KP Chang.为本次发行提供境外法律服务，聘请弗若斯特沙利文（北京）咨询有限公司上海分公司提供募投项目咨询服务。

经核查，保荐人认为：冠礼科技本次发行上市中有偿聘请第三方机构和个人情况符合《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁从业风险防控的意见》（证监会公告[2018]22 号）的相关规定。

九、发行人存在的主要风险

本着勤勉尽责、诚实守信的原则，经过充分的尽职调查和审慎核查，根据发行人的有关经营情况及业务特点，本保荐人特对以下风险做出提示和说明：

（一）与发行人相关的风险

1、应收款项规模较大风险

报告期各期末，公司应收账款账面余额分别为 20,346.46 万元、27,893.06 万元及 33,759.58 万元，占当期营业收入的比例分别为 24.13%、21.76%及 25.38%，整体呈增长趋势。公司已按照企业会计准则及会计政策要求，基于账龄组合对应收账款计提了相应的坏账准备，报告期各期末坏账准备余额分别为 2,802.63 万元、3,810.77 万元及 3,628.29 万元。

公司下游客户主要为国有企业、上市公司及行业龙头企业，资信状况整体良好，但该类客户内部付款审批流程较为复杂、结算周期相对较长，导致公司应收账款回收管理难度及工作量较大。若未来宏观经济环境发生不利变化，或部分客户因经营状况恶化、资金周转压力等因素导致支付能力下降，而公司未能及时识别风险并采取有效催收措施，则可能存在应收账款回收周期延长、坏账损失增加的风险，进而对公司现金流状况及经营业绩产生不利影响。

2、存货跌价风险

报告期内，随着公司业务规模持续增长，项目执行周期内累计投入的合同履约成本规模较大。报告期各期末，公司存货中合同履约成本账面余额分别为 93,901.11 万元、106,862.79 万元及 75,905.77 万元，占各期末流动资产的比例分别为 51.07%、50.23%及 45.04%，整体规模较大。

若未来出现半导体行业景气度下行、下游客户经营状况恶化或资金压力加剧等不利情形，可能导致部分项目执行进度放缓、合同范围调整或终止。在此情况下，公司存货可能存在跌价风险，且部分已发生的大额项目成本可能无法通过合同款项得到全额补偿，从而对公司财务状况及经营成果产生不利影响。

3、核心技术相关风险

公司掌握多项具有自有知识产权的核心技术，涵盖了公司主要产品的研发、设计及生产工艺等，是产品市场竞争力的关键依托。若因内部工作疏忽、管理不善、外界恶意窃取等情形导致公司核心技术泄露、知识产权遭受侵害，将会对公

司的生产经营和技术创新造成不利影响。

稳定的研发团队是公司长期保持技术领先、市场竞争力及成长潜力的重要基础。公司将人才建设作为发展重点，优化激励机制与竞业约束条款，稳步扩充技术人员梯队，保障核心研发团队稳定。随着业务规模不断扩张，公司对高端技术人才的需求持续提升，若核心技术人员流失、高端人才引进滞后，不仅会延缓在研项目推进，还将加大核心技术泄露隐患，从而影响公司经营业绩。

4、控股股东同业竞争风险

公司直接控股股东台湾朋亿经营高科技产业制程化学品供应系统销售与整合工程服务，属于与公司的主营业务存在相同或相似业务的情况。报告期内，公司与台湾朋亿在中国台湾以外地区存在不构成重大不利影响的同业竞争的情形。截至报告期末，双方已不存在同业竞争。除此以外，公司控股股东及其控制的其他企业与公司不存在同业竞争的情况。台湾朋亿 2023 年和 2024 年竞争性业务产生的收入或毛利合计未超过公司主营业务收入或毛利的 30%，2025 年台湾朋亿不存在与公司产生竞争性业务的收入，其与公司的同业竞争未对公司经营产生重大不利影响。

若未来台湾朋亿在中国台湾以外市场的收入或毛利规模进一步扩大，且未能合理规划并修正其旗下经营主体的业务方向及细分市场领域，则可能构成对公司存在重大不利影响的同业竞争，进而对公司的业务发展构成一定的不利影响。

（二）与行业相关的风险

1、行业需求波动与技术迭代风险

公司所属行业为半导体器件专用设备制造业，主要产品广泛应用于集成电路、显示面板及电子化学品等高端制造领域。报告期各期，公司主要产品收入占主营业务收入的比例分别为 98.57%、98.57%及 98.62%，其市场需求与下游行业景气度、资本开支规模高度相关，周期性特征较为显著。

集成电路、显示面板等行业作为电子信息产业的核心支柱，其发展节奏与宏观经济环境、国际贸易格局、终端消费市场需求、技术迭代进程、产业扶持政策

等多重因素深度绑定，若未来全球半导体产业景气度进入下行周期，AI 算力、消费电子、新能源汽车等下游终端市场需求不及预期，将直接导致厂商收缩资本开支计划、放缓新建产线布局与现有产能扩张节奏，进而使得市场对公司核心产品的采购需求出现大幅波动。在此情形下，公司将面临新增订单获取不及预期、在手项目交付周期延长、营业收入与利润规模下滑的经营风险。

与此同时，下游行业技术迭代迅速，先进制程产线对配套设备的精度、稳定性、洁净度等核心指标要求持续升级。若公司未能紧跟下游行业技术迭代步伐，及时完成适配先进制程产线的技术研发与产品升级迭代，将无法持续满足下游客户的核心需求，进而面临市场份额下滑、核心竞争力弱化的不利局面，对公司持续盈利能力造成影响。

2、市场竞争加剧风险

公司所处行业是集成电路、显示面板及电子化学品生产环节的关键配套领域，公司产品性能直接决定下游产线的制程精度、运行稳定性与产品良率，具备技术壁垒高、客户认证周期长、品牌粘性强的特征。全球市场范围内，该领域早期由国际巨头主导，该类企业凭借长期技术积累、全球化的供应链布局与服务网络、丰富的产品矩阵，与主流厂商建立了深度合作关系，具备较强的市场竞争优势。而随着半导体产业国产化进程的持续加速，国内市场亦涌现出多具备技术研发能力与规模化交付能力的同行业企业，参与者持续增加使得市场竞争日趋激烈。国内同行业企业依托本土化服务优势、成本优势与政策扶持红利，在成熟制程领域快速实现技术突破与客户认证，逐步形成了自身的细分赛道优势与客户资源壁垒；更有部分企业通过产能扩张、产业链上下游协同布局等策略，持续抢占市场份额，进一步加剧了市场的竞争格局。

目前，公司在全品类产品覆盖、先进制程领域的技术储备等方面已形成差异化的竞争优势，整体业务规模与全球化市场布局亦处于稳步拓展阶段。但若未来国际龙头企业加码中国市场本土化布局与价格竞争，国内同行业企业亦通过技术突破、服务升级持续争夺市场份额，而公司未能通过技术创新、产品迭代、成本管控巩固核心竞争力，将面临市场竞争加剧的风险，进而出现市场份额萎缩、毛利率下滑及经营业绩不及预期的影响。

3、原材料供应风险

公司主要产品主要应用于集成电路、显示面板等领域，对洁净度、耐腐蚀性及系统稳定性要求较高，其性能与阀门、过滤器、泵浦等专用部件密切相关，该类部件的核心技术及生产工艺长期由欧美、日本厂商掌握，短期内实现完全国产化替代的难度较大。因此，公司阀件、泵浦、管件等核心部件较大比例采用进口品牌，存在对进口原材料的依赖。

同时，报告期内公司原材料成本占主营业务成本的比例较高，原材料价格波动对公司盈利能力影响显著。若未来因国际贸易政策调整、地缘政治因素、物流管制或供应链扰动等情形，导致核心零部件采购价格大幅上涨、交付周期延长或供应稳定性下降，公司可能面临生产成本上升、项目交付延迟及毛利率承压等风险，进而对经营业绩产生不利影响。

（三）其他风险

1、汇率波动风险

报告期内，公司主营业务中外销收入分别为 5,652.57 万元、10,391.19 万元和 6,921.57 万元，占主营业务收入的比例分别为 6.73%、8.19%和 5.25%。公司外销业务主要以新加坡元和美元结算，报告期内公司汇兑收益分别为 5.69 万元、6.74 万元和-27.31 万元。未来，若境外经济环境、货币政策等发生变化，汇率波动幅度加大，可能导致公司汇兑损益波动增大，从而对经营业绩产生影响。

2、募集资金投资项目风险

公司募集资金主要投向半导体高端装备产能升级与智造基地建设项目、高端电子化学品智能供应产线及半导体核心工艺装备研发项目、电子溶剂绿色再生高效系统研发项目、营销总部及营销网络建设项目。上述项目的实施将进一步提高公司的市场竞争力，扩大公司产能，提升经营业绩，优化公司财务结构。上述项目经过公司详细的市场调研及可行性论证并结合公司实际经营状况和技术条件而最终确定，由于在募集资金投资项目实施过程中仍然会存在各种不确定因素，可能会影响项目的完工进度和经济效益，从而对公司的经营业绩产生不利影响。

3、所得税优惠政策变化的风险

报告期内，公司及子公司上海冠礼享受高新技术企业 15%的企业所得税税率。若公司未来期间不能通过高新技术企业评审，或者国家所得税优惠政策发生变化，公司存在无法享受所得税优惠政策的风险，公司经营业绩将受到不利影响。

4、控股股东不当控制的风险

公司直接控股股东台湾朋亿持有公司发行前 86.59%股权，虽然公司已建立较为完善的公司治理结构及内部控制制度，但是控股股东仍能够通过所控制的表决权控制公司的重大经营决策，形成有利于控股股东但有可能损害公司及其他股东利益的决策。如果相关内部控制制度不能得到有效执行，存在公司控股股东利用其控制地位损害其他中小股东利益的风险。虽然公司已经建立了较为完善的内部决策及管理制度，但若控股股东通过行使表决权、管理职能等方式对公司人事任免安排、对外投资、资产处置等方面产生控制不当的行为，可能对公司及其他股东的权益产生不利影响。

十、发行人发展前景的评价

最近三年，发行人营业收入总体上呈增长态势，净利润快速增长，取得了良好的经济效益。本保荐人在对发行人进行全面调查和分析后认为，发行人具有较好的发展前景，主要表现在以下几个方面：

（一）主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略情况

公司主要从事高纯工艺介质系统与高阶湿制程工艺设备的研发、设计、生产与销售。根据《国民经济行业分类 GB/T4754-2017》，公司所处行业为“C35 专用设备制造业”中“C3562 半导体器件专用设备制造”。根据《战略性新兴产业分类（2018）》，公司所属行业为“1 新一代信息技术产业”中的“1.2.1 新型电子元器件及设备制造”。近年来，国家相关部门已陆续出台多项泛半导体产业政策和经济发展战略，公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略。

（二）自动化化学品与研磨液供应系统技术优势加持助力公司业绩稳定增长

作为公司营业收入的核心贡献产品，公司的自动化化学品与研磨液供应系统以输送纯净与稳定的工艺介质为核心目标，依据不同化学特性选用不同的高洁净耐腐材料，从硬件端保障核心工艺指标的精准控制。在金属控制方面，公司该产品对金属杂质控制可达到 SEMI G5 等级；在颗粒控制方面，在 28nm 以下的先进制程中可实现颗粒 $\geq 0.02\mu\text{m}$ 、 $< 10\text{-}20$ 个/mL 的控制，达到行业领先水平；在输送稳定性方面，系统搭载全自动流量监控与液气分离装置，配备带压差监测功能的安全通排风管道，全方位保障工艺安全与介质输送的稳定性连续保障生产方面，系统配备智能旁路（Bypass）功能与冗余泵组自动切换设计，可在泵组失效时自动完成无缝切换，避免断液风险，保障下游产线连续稳定运行；在维护便捷性方面，产品采用管路与核心部件的快拆式连接设计，从而便利维护。

公司凭借长期积累的研发技术实力，形成可持续的市场竞争力，主要产品广泛应用于集成电路、显示面板及电子化学品等领域，为业绩稳健增长提供坚实支撑。

（三）公司具有较强的市场竞争力

公司作为国内高纯工艺介质系统领域的先行者，凭借二十余年的深厚的技术积淀，始终引领行业技术发展，精准响应客户的差异化需求，并持续推动产品创新与迭代。

凭借对下游客户核心诉求的深刻理解，公司以高纯工艺介质系统为业务核心，成功将业务拓展至集成电路、显示面板及电子化学品等多元产业链，积累了丰富的客户资源。公司着力于维系与优质客户的合作，已覆盖多个关键下游行业的国内外头部企业，包括中芯国际、华虹半导体、合肥晶合、长江存储、长鑫存储等知名国内龙头企业，以及住友化学等具备全球影响力的国际客户。凭借可靠的产品质量与技术服务，公司多次被中芯国际等重要客户评为“优质供应商”，充分体现了客户对公司综合能力的高度认可。

根据弗若斯特沙利文统计，冠礼科技凭借全链条技术壁垒、头部晶圆厂客户的认证与深度合作以及在国产替代进程中的先发优势已跻身中国半导体液化化

学品供应系统行业第一梯队，市场占有率居行业标杆地位，影响力持续提升。

（四）公司所处行业的市场空间广阔

根据 SEMI 统计数据，2025 年全球半导体制造设备总销售规模达到 1,351 亿美元，同比增长 15%，创历史新高；预计 2026 年、2027 年，全球半导体设备总销售规模有望继续攀升至 1,520 亿美元和 1,660 亿美元。

晶圆厂设备领域(含晶圆加工、晶圆厂设施和掩模版设备)因 DRAM 及 HBM 投资强于预期及中国持续扩产，预计 2025 年将增长 11.0%至 1,157 亿美元，打破于 2024 年创下的 1,040 亿美元纪录；2026、2027 年预计再增 9.0%和 7.3%。后端设备领域 2025 年半导体测试设备销售额预计激增 48.1%至 112 亿美元，封装设备销售额增长 19.6%至 64 亿美元。2026、2027 年测试设备销售额预计继续增长 12.0%和 7.1%，封装设备销售额预计增长 9.2%和 6.9%。

从产品结构来看，光刻设备、刻蚀设备、薄膜沉积设备作为晶圆制造环节的核心工艺装备，合计占全球半导体设备市场比例超过 60%，系行业内技术壁垒最高、投资规模最大的细分领域。与此同时，随着制程节点的演进，对表面洁净度、缺陷控制及掺杂精度的要求呈指数级提升，湿法清洗、量测检测、离子注入、热处理等设备的重要性持续上升，其中湿法设备成为近年来增长较快的细分领域之一，2025 年全球湿法设备市场规模同比增长超过 7%。

综上，公司主要产品和业务符合产业政策和国家经济发展战略，核心产品自动化化学品与研磨液供应系统长期占据市场主导地位，主要应用于集成电路、显示面板等下游行业，为生产环节提供稳定、高纯的工艺介质输送保障。公司凭借全链条技术壁垒、头部晶圆厂客户的认证与深度合作以及在国产替代进程中的先发优势已跻身该领域第一梯队，市场占有率居行业标杆地位，市场影响力持续提升。同时，公司所处半导体设备行业未来市场空间广阔，发行人具有较好的发展前景。

（本页无正文，为《东吴证券股份有限公司关于苏州冠礼科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市之发行保荐书》之签章页）

项目协办人： 姜振兴
姜振兴

保荐代表人： 张博雄 夏建阳
张博雄 夏建阳

保荐业务部门负责人： 杨淮
杨淮

内核负责人： 杨伟
杨伟

保荐业务负责人： 方苏
方苏

保荐人总经理： 薛臻
薛臻

保荐人法定代表人、董事长： 范力
范力



保荐代表人专项授权书

深圳证券交易所：

东吴证券股份有限公司作为苏州冠礼科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》的有关规定，授权张博雄、夏建阳担任苏州冠礼科技股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市的保荐代表人，负责该公司发行上市尽职保荐及持续督导等保荐工作事宜。

特此授权！

保荐代表人：

张博雄
张博雄

夏建阳
夏建阳

公司法定代表人：

范力
范力

